

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司申请融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请融资业务提供担保，具体情况如下：

（1）公司子公司天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“环鑫科技”），拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请融资不超过 1,000 万元，期限一年，用于日常经营活动。该笔融资业务由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（2）公司子公司天津鑫天和电子科技有限公司（以下简称“鑫天和”），拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请融资不超过 6,000 万元，期限一年，用于日常经营活动。该笔融资业务由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，还需经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、环鑫科技为公司全资子公司，2008 年 6 月 18 日注册成立。

名称：天津环鑫科技发展有限公司

法人代表：王彦君

注册资本：74,158 万元人民币

经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪；物业管理。

截至 2019 年 6 月 30 日，环鑫公司总资产 86,465.37 万元，净资产 70,561.57 万元，2019 年 1-6 月营业收入 10,568.63 万元，净利润-313.16 万元（未经审计）。

2、鑫天和为公司全资子公司，2009 年 6 月 1 日注册成立。

名称：天津鑫天和电子科技有限公司

法人代表：张长旭

注册资本：26,320 万元人民币

经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构；电子元器件、电器设备制造、加工。

截至 2019 年 6 月 30 日，鑫天和总资产 110,313.03 万元，净资产 28,005.74 万元，2019 年 1-6 月营业收入 244,434.34 万元，净利润 683.03 万元（未经审计）。

三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要，是根据投资规划及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额为 690,029.57 万元，实际累计对外担保额为 597,098.40 万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币 697,029.57 万元（其中为控股子公司提供的担保额为 668,379.57 万元），占 2018 年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属于母公司净资产的比例为 52.31%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 9 月 3 日